证券代码：600460　　证券简称：士兰微　　公告编号：临 2026-037

杭州士兰微电子股份有限公司
关于为控股子公司提供日常担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额（万元）	截至 2026 年 10 月 31 日实际为其提供的担保余额（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
成都士兰半导体制造有限公司（以下简称“成都士兰”）	25,440.00	13,621.98	是	否

- **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	524,815.20
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	43.85

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

2026 年 10 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在年度预计日常担保额度内实际签署的担保合同如下：

担保合同签署日期	担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
2026 年 10 月 29 日	保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	成都士兰半导体制造有限公司	国家开发银行四川省分行	担保的债权额为人民币 25,440.00 万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	主合同项下债务履行期届满之日起三年

本次担保无反担保。本次担保非关联担保。本次被担保人成都士兰的其他股东未提供担保。

（二） 内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第九次会议和 2026 年 5 月 26 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年度对子公司提供日常担保额度的议案》，同意公司在 2026 年度对资产负债率为 70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过 29 亿元。实际发生日常担保时，公司可以在上述预计的日常担保总额度内，对资产负债率为 70%以下的不同控股子公司（包含年中新增或新设的控股子公司）进行相互调剂。本次担保预计金额包含以前年度延续至 2026 年度的日常担保余额。本次担保预计额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如公司 2026 年年度股东会与 2025 年年度股东会间隔超过 12 个月的，在 2026 年年度股东会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保依然有效。股东会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日和 2026 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2026-010、临 2026-016 和临 2026-025。

本次担保在上述股东会批准的担保额度范围内，无须另行召开董事会及股东会审议。

（三）截至 2026 年 10 月 31 日：

1、公司为成都士兰实际提供的担保余额为 13,621.98 万元，其中日常担保余额为 10,000.00 万元，专项担保余额为 3,621.98 万元，担保余额在公司相关股东会批准的担保额度范围内。

2、公司日常担保余额为 140,289.57 万元，剩余可用担保额度为 149,710.43 万元；担保余额在公司 2025 年年度股东会批准的年度预计日常担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一） 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	成都士兰半导体制造有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	本公司直接持有 64.15% 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司直接持有23.90% 成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司直接持有10.28% 成都天府水城鸿明投资有限公司直接持有 1.67%		
法定代表人	陈向东		
统一社会信用代码	91510121564470905W		
成立时间	2010 年 11 月 18 日		
注册地	四川省成都市金堂县淮口街道成都-阿坝工业集中发展区士芯路 9 号		
注册资本	316,969.70 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	422,083.08	353,861.56
	负债总额	87,772.94	67,429.71
	资产净额	334,310.15	286,431.86
	营业收入	94,309.09	110,247.50
	净利润	-12,121.71	-14,967.86

注：上表数据为母公司报表口径，尾差系四舍五入所致。

（二） 成都士兰为本公司之控股子公司，其未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	成都士兰半导体制造有限公司	国家开发银行四川省分行	担保的债权额为人民币 25,440.00 万元及其利息、费用等	连带责任保证担保	主合同项下债务履行期届满之日起三年

本次担保无反担保。本次担保非关联担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足控股子公司成都士兰日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人成都士兰生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力；公司担保主要系应贷款方要求提供的增信措施，触发担保责任风险可控。

被担保人成都士兰为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，能够有效监控其资信状况和履约能力，担保风险处于公司可控范围内；被担保人成都士兰的其他股东主要系财务投资和产业扶持的专业产业投资基金，持股比例较小，且不参与其日常经营。故被担保人成都士兰的其他股东暂无明显提供担保的必要性，其未提供同比例担保，不违背公平、对等原则。

本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第九次会议和 2026 年 5 月 26 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年度对子公司提供日常担保额度的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日和 2026 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2026-010、临 2026-016 和临 2026-025。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为 52.482 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.85%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 42.374 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 35.40%；公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为 10.108 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 8.45%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（注：担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日